

Daten und Unterlagen

Folgende Unterlagen / Angaben garantieren einen reibungslosen Ablauf für die Offert Erstellung und Fertigung Ihrer Baugruppe.

Wir sind gerne bereit, diese Angaben und Dokumente mit Ihnen zu erarbeiten.

Allgemein Angaben:	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktdaten • Artikelbezeichnung • Menge • Wunschliefertermin
Stückliste:	<ul style="list-style-type: none"> • In elektronischer Form (in Excel von Vorteil) • Bauteilreferenzen und Bauteilangaben (Spezifikation) • Allfälliges Beistellmaterial markiert
Bestückungszeichnung:	<ul style="list-style-type: none"> • In elektronischer Form (z.B. pdf) • Bauteilreferenzen und Polaritäten eingezeichnet
Leiterplatten Daten:	<ul style="list-style-type: none"> • Von Vorteil Gerberdaten im RS274-x Format • Allfällige Nutzen Zeichnung (wird auch gerne durch uns erstellt) • Leiterplatten Spez. (Material, Dicke, Oberfläche, Spezielles)
Spezielles:	<ul style="list-style-type: none"> • Pick and Place Daten in elektronischer Form • Allfällige Arbeitsanweisungen / Montageanweisungen

Grenzwerte der Produktion

Mechanisch:

	Minimal [mm]	Maximal [mm]	Rand* [mm]	Maximale Bauteil Höhe [mm]
Automatisches SMD Bestücken & Lötén	50 x 50	500 x 400	3	15
Automatisches THD Lötén	80 x 80	460 x 460	5	89

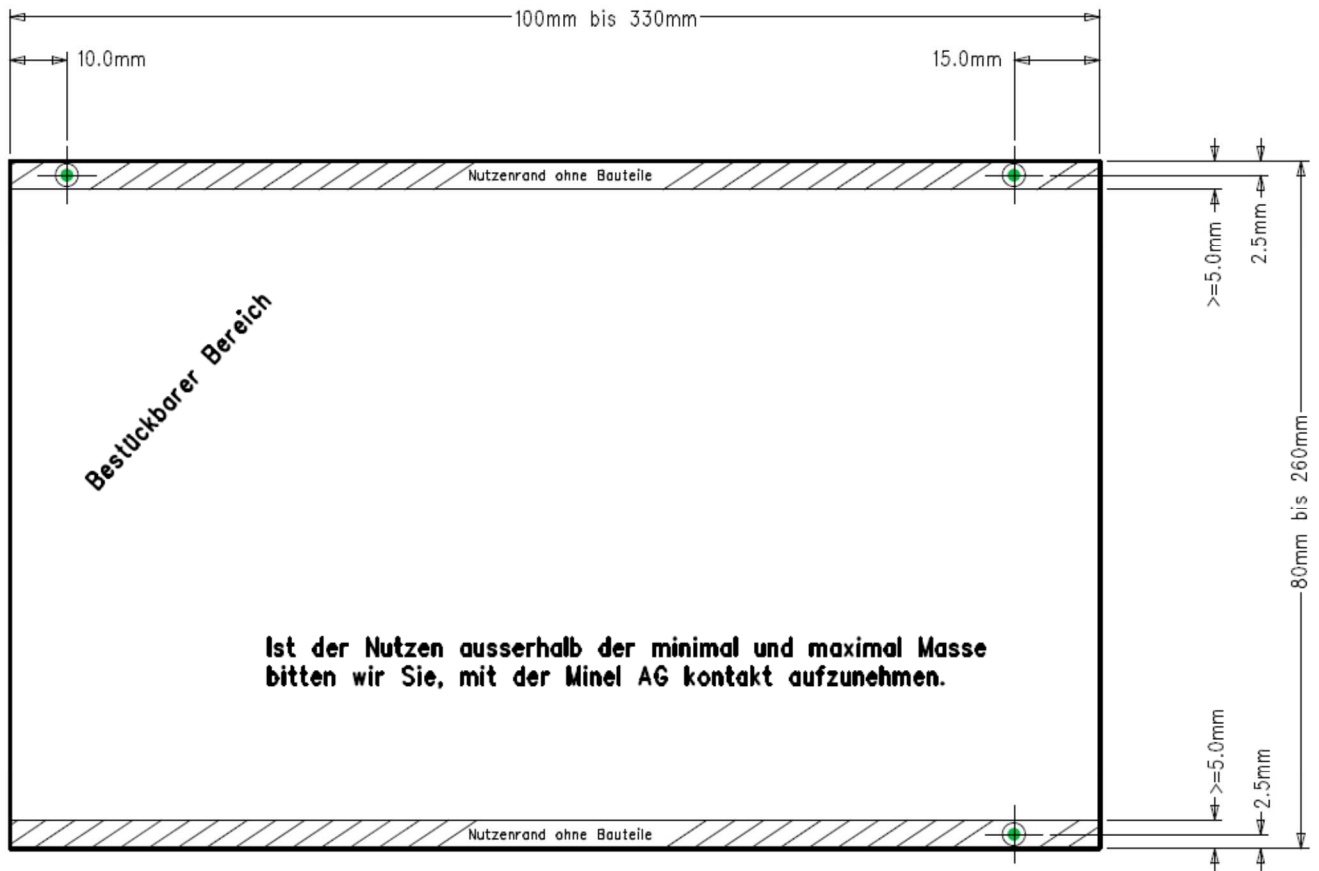
*Rand = Bauteilfreie Zone am Printrand

Printmasse ausserhalb der Grenzwerte, oder Manuelle Bestückungen (SMD und THD) klären wir Ihnen gerne Produktespezifisch ab.

Thermisch:

	Maximal [°C]
Dampfphasenlötén (SMD)	230
Automatisches THD Lötén	280
Temperofen (für Leiterplatten und Bauteile)	80

Optimal Nutzengrösse



ERKENNUNGSMARKEN BEIDSEITIG

